



KC ČIP.SI
SLOVENSKI KOMPETENČNI
CENTER ZA ČIPE

NOVIČNIK

Petek, 23. oktober 2026

Pozdravljeni,
v tokratnem novičniku vam posredujemo pregled aktualnega dogajanja v svetu čipov, polprevodniških tehnologij, inovacij in novih trendov. Posebej vas želimo opozoriti na dve pomembni prihajajoči aktivnosti: dvodnevno delavnico FPGAs for High Performance Computing, namenjeno spoznavanju uporabe FPGA tehnologij v visokozmogljivem računalništvu, ter uradni zagon evropske platforme EuroCDP (European Chips Design Platform), ki bo odpiral nove priložnosti za podporo razvoju naprednih čipov in polprevodniških inovacij v Evropi.

Želimo vam prijetno branje!

Dogodki KC Čip.si:

- Delavnica: [FPGAs for High Performance Computing](#)
4.-5. november, 2026, on-line

Vabimo vas na dvodnevno spletno delavnico kjer boste udeleženci spoznali osnove visokozmogljivega računalništva (HPC), arhitekture superračunalnikov in vlogo strojnih pospeševalnikov. Poseben poudarek bo namenjen programiranju FPGA vezij s pristopom High-Level Synthesis (HLS), ki omogoča razvoj FPGA pospeševalnikov v programskih jezikih C/C++ namesto klasičnih strojnih opisnih jezikov.

Delavnica bo vključevala tudi praktične primere optimizacije, prenosa podatkov med gostiteljskim sistemom in FPGA ter razvoj pospeševalnika za matrični razcep Cholesky na platformah AMD-Xilinx.

Delavnico soorganizirata: Konzorcijski partner KC Čip.si, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) in kompetenčni center: Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje SLING.si.

Udeležba je brezplačna.

Udeleženci bodo prejeli tudi certifikate o udeležbi.

Registracija je odprta do **31. Oktobra 2026**.

[Prijava na delavnico](#)

- Opomnik za Webinar: [Webinar on Semiconductor Training Offers #2](#)
27. oktober, 2026, 10:00 – 10:45, on-line
Na dogodek se prijavite [tukaj](#).
- Opomnik za Webinar: [Chip Think Tank: Rethinking Advanced Packaging for Strategic Markets](#)

28. oktober, 2026, 12:00 – 13.00, online
Registracija na spletni dogodek [tukaj](#).

- Dogodek: **Official launch of the European Chips Design Platform (EuroCDP)**

4. novembra 2026, Bruselj, Belgija

Z veseljem sporočamo uradni zagon platforme EuroCDP (European Chips Design Platform), pomembne evropske pobude za podporo razvoju čipov in polprevodniških inovacij. Platforma bo povezovala start-upe, podjetja, raziskovalne organizacije in inovatorje z mrežo strokovnjakov ter t. i. Design Enablement Teams (DET), ki bodo uporabnikom nudili podporo na celotni poti razvoja, od začetne ideje in načrtovanja do prototipiranja ter izdelave najsodobnejših čipov novih generacij.

EuroCDP bo omogočal dostop do naprednih orodij za načrtovanje čipov, ekspertnega znanja, usposabljanj, partnerske mreže in drugih storitev, potrebnih za hitrejši in učinkovitejši razvoj inovativnih polprevodniških rešitev.



Drugi dogodki:

- Webinar: **Accessing European Photonics Integrated Circuits expertise and infrastructure – PIXEurope Pilot Line and PixSpain Chip Competence Center**

29. oktober, 2026, 10:00 – 11:00, on-line

Na seminarju bosta PIXSpain in PIXEurope predstavila, kako lahko podjetja, raziskovalci in inovatorji dostopajo do vrhunskega znanja, infrastrukture ter storitev za razvoj, izdelavo, pakiranje, testiranje in validacijo fotonjskih integriranih vezij ter tako pospešijo njihov prehod v industrijsko uporabo.

[Prijava na webinar](#)



- Posnetek webinarja: [**Webinar Recording Now Available: Your Gateway to European Semiconductor Technologies | aCCcess**](#)
Posnetek skupnega webinarja KC Čip.si, češkega in slovaškega centra z EuroCDP, PIXEurope in NanoIC. Obravnava dostop do pilotnih linij, EDA-orodij, IP-knjižnic in PDK-jev ter poti od ideje do prototipa. Dostop do posnetka [tukaj](#).

Novice KC Čip.si:

- EuroCDP usposabljanja in webinarji: [**Build your chip design skills with EuroCDP training and webinars**](#)
EuroCDP omogoča praktično usposabljanje za zagonska podjetja, MSP-je in strokovnjake s področja polprevodniških in čipovnih tehnologij. Program vključuje strokovne spletne seminarje, ciljno usmerjena usposabljanja ter praktične delavnice, prilagojene potrebam industrije. Ponudbo preverite na: <https://eurocdp.eu/training>

Razpisi:

- Pomembna sprememba: **Rok za AI razpisa podaljšan do 1. decembra 2026**
Chips JU je rok za oddajo prijav na oba aktualna razpisa s področja umetne inteligence podaljšal z 27. oktobra na 1. december 2026 (17.00).
Razpisa s skupnim proračunom 80 milijonov EUR naslavljata razvoj AI čipov in računske infrastrukture za umetno inteligenco:
[AI chip demonstrators for EU compute infrastructure](#)
[AI compute evaluation and deployment platform for EU infrastructure](#)
Podaljšanje roka predstavlja dodatno priložnost za podjetja, raziskovalne organizacije in druge deležnike, da pripravijo kakovostne projektne predloge in se vključijo v razvoj prihodnjih evropskih AI in polprevodniških rešitev.

Novice:

- [**Siemens and NVIDIA speed up AI chip lithography by 12x**](#)
S tehnologijama Calibre in cuLitho je možno doseči do 12-krat hitrejšo izvajanje zahtevnih litografskih izračunov pri načrtovanju in proizvodnji naprednih AI čipov. Rešitev bo proizvajalcem omogočila hitrejšo optimizacijo fotomask, zgodnejše odkrivanje napak ter učinkovitejšo uporabo prihajajoče tehnologije [High-NA EUV litografije](#). Pospešitev naj bi skrajšala razvojne cikle in izboljšala proizvodni izkoristek prihodnjih generacij procesorjev in pomnilniških čipov za UI.
- [**TSMC is seeking chipmaking equipment that doesn't contain Chinese rare-earth magnets**](#)

TSMC skupaj z dobavitelji preučuje uporabo električnih pogonov brez redkozemeljskih magnetov, da bi zmanjšal odvisnost od Kitajske in okrepil odpornost dobavnih verig. Magneti predstavljajo eno izmed ključnih komponent za številne avtomatizirane sisteme v polprevodniških tovarnah in bi morebitne motnje v dobavi lahko neposredno vplivale na proizvodnjo naprednih čipov in drugih elektronskih komponent.

- **Chip Scaling Moves Beyond The Transistor**

Napredek polprevodniške industrije bo vse bolj temeljil na novih in izboljšanih načinih naprednih postopkov pakiranja čipov, integriranih fotoniki, višje stopnje sistemske integracije, ne le zgolj na nadaljnjem pomanjševanju tranzistorjev. Rast povpraševanja, ki jo poganjajo umetna inteligenca, robotika in digitalna infrastruktura, hkrati postavlja umetno inteligenco tudi v vlogo pomembnega orodja za načrtovanje in proizvodnjo čipov.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,
ekipa KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran: <https://cc-chip.si/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREENOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

